

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2023]23 号

关于召开《改良西门子法多晶硅用硅芯》等 11 项半导体材料 标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会及工业和信息化部下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及 2023 年标委会工作安排，现定于 2023 年 9 月 11 日～13 日在江苏省如皋市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事项通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《改良西门子法多晶硅用硅芯》等 11 项半导体材料标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于 9 月 4 日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 9 月 6 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2023 年 9 月 11 日全天。

2、报到地点：如皋开元名都大酒店（江苏省南通市如皋市南惠政东路 158 号）。

3、乘车路线：①南通兴东机场：乘 622 路公交车至钟楼广场站，换乘轨道交通 1 号线至茶庵站，换乘 H02 路公交至龙游河湿地公园站下车，步行 1 公里即可到达；全程约 60 公里，乘出租车约 120 元。②如皋站：乘坐如皋 106 路公交至龙游御境站下车，步行 700 米即可到达；全程约 5 公里，乘出租车约 10 元。③如皋南站：乘坐如皋 109 路公交至龙游御境站下车，步行 700 米即可到达；全程约 6 公里，乘出租车约 12 元。

三、会务及联系人

本次会议由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会和如皋市化合物半导体产业研究所共同主办，江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会、如皋市市场监督管理局和江苏秦烯新材料有限公司共同协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫微 010-62257692。

会议会务：袁正川 18709316115

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2023 年 9 月 4 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，9 月 4 日之后及现场

缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：9 月如皋半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议审定、预审和讨论的标准项目

二〇二三年八月十四日

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

序号	组别	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
1	第一组	工信厅科函[2022]94号 2022-0108T-YS	改良西门子法多晶硅用硅芯	江苏中能硅业科技发展有限公司	审定
2		国标委发[2021]41号 20214647-T-469	半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分：高度径向二阶导数法（ZDD）	山东有研半导体材料有限公司	审定
3		工信厅科函[2022]94号 2022-0110T-YS	硅片包装和标志	浙江海纳半导体有限公司	审定
4		工信厅科函[2022]94号 2022-0111T-YS	晶片包装片盒表面颗粒的测试 液体颗粒计数法	麦斯克电子材料股份有限公司	审定
5		国标委发[2022]17号 20220133-T-469	埋层硅外延片	南京国盛电子有限公司	预审
6		国标委发[2022]17号 20220134-T-469	碳化硅外延片	南京国盛电子有限公司	预审
7	第二组	工信厅科函[2022]94号 2022-0082T-YS	高纯钢	云南锡业集团控股有限公司	审定
8		工信厅科函[2022]94号 2022-0083T-YS	高纯钢化学分析方法 第1部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法	国标（北京）检验认证有限公司	审定
9		工信厅科函[2022]158号 2022-0574T-YS	分子束外延（MBE）用高纯铝源	南通泰德电子材料科技有限公司	预审
10		国标委发[2021]28号 20214216-T-469	III族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	讨论
11		工信厅科函[2022]158号 2022-0573T-YS	半绝缘砷化镓单晶衬底片	广东先导微电子科技有限公司	预审